

上市公司名称: 北京耐威科技股份有限公司

股票简称: 耐威科技

上市地点: 深圳证券交易所

股票代码: 300456

**北京耐威科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书
(草案) 摘要 (修订稿)**

序号	交易对方	住所/通讯地址
1	北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢 6 层 601 室/北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 1 座 401 室
2	徐兴慧	山东省临朐县朐阳街****/北京市海淀区中关村南大街 12 号四区 10 幢 209 室
序号	募集配套资金特定对象	住所/通讯地址
1	北京亦庄国际投资发展有限公司	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢/北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 BDA 国际企业大道 61 栋
2	周志文	北京市丰台区怡海花园恒泰园****/北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号
3	杨云春	北京市丰台区百强大道****/北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A2608 室

独立财务顾问



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

二零一五年十二月

公司声明

一、北京耐威科技股份有限公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告书内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。

三、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

五、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方的声明与承诺

本次发行股份购买资产的交易对方北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)、徐兴慧以及本次发行股份购买资产募集配套资金的认购方北京亦庄国际投资发展有限公司、周志文和杨云春均已承诺:

已向北京耐威科技股份有限公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次交易事宜在现阶段必须的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或书面陈述和说明,不存在任何虚假和重大遗漏之处;所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的;所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的,并已履行该等签署和盖章所需的法定程序,获得合法授权;所有书面陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

根据本次交易的进程,将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,及时向北京耐威科技股份有限公司提供本次交易相关信息和文件,并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。

如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给北京耐威科技股份有限公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让在北京耐威科技股份有限公司拥有权益的股份。

目 录

公司声明	2
交易对方的声明与承诺	3
目 录	4
释 义	5
一、普通术语	5
二、专业术语	7
第一节 重大事项提示	10
一、本次交易方案概述	10
二、本次交易标的资产价格	10
三、本次交易发行股份的价格、数量及锁定安排	11
四、业绩承诺和业绩补偿	13
五、目标公司赛莱克斯剩余 2%股权的安排	14
六、本次交易构成重大资产重组	15
七、本次交易构成关联交易	15
八、本次交易不构成借壳上市	16
九、本次交易对上市公司的影响	16
十、本次交易的决策过程	18
十一、本次交易相关方所作出的重要承诺	19
十二、本次交易中对中小投资者权益保护的安排	26
十三、独立财务顾问的保荐资格	27
第二节 特别风险提示	28
一、与本次交易相关的风险	28
二、本次交易完成后的风险	32
第三节 本次交易概述	35
一、本次交易的背景和目的	35
二、本次交易的具体方案	38
三、本次交易的决策过程和批准情况	43
四、本次交易构成重大资产重组	44
五、本次交易构成关联交易	44
六、本次交易不构成借壳上市	44
七、本次交易对上市公司的影响	45

释 义

本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

一、普通术语

公司、本公司、上市公司、耐威科技	指	北京耐威科技股份有限公司
交易对方	指	北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧
北京集成电路投资中心	指	北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）
瑞通芯源、标的公司、标的资产	指	北京瑞通芯源半导体科技有限公司，为控股型公司，无实际生产经营业务
交易标的、标的公司股权	指	瑞通芯源合计 100%的股权
赛莱克斯、Silex、Silex 公司、目标公司	指	Silex Microsystems AB，注册在瑞典的公司，为瑞通芯源的间接控股子公司，从事微机电系统（MEMS）产品工艺开发及代工生产业务
运通电子	指	运通电子有限公司（GLOBAL ACCESS ELECTRONICS LIMITED），为瑞通芯源 100%持股的在香港设立的控股型公司，无生产经营业务，持有赛莱克斯 98%的股权
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	耐威科技向北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧发行股份购买资产，并向北京亦庄国际投资发展有限公司、周志文、杨云春非公开发行股票募集配套资金的行为
本次配套融资、配套融资	指	耐威科技发行股份购买资产的同时，拟向 3 名特定对象非公开发行股票募集配套资金
本次发行股份购买资产的发行对象	指	北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧
本次配套融资的发行对象、锁价发行对象	指	北京亦庄国际投资发展有限公司、周志文、杨云春
盛世宏明	指	北京盛世宏明投资基金管理有限公司，为北京集成电路投资中心的普通合伙人及执行事务合伙人
北京集成电路基金	指	北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司，为北京集成电路投资中心的有限合伙人
亦庄投资中心	指	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙），为北京集成电路投资中心的有限合伙人
国家集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司，为北京集成电路投资中心的有限合伙人
亦庄国投	指	北京亦庄国际投资发展有限公司
经开区办公室	指	北京经济技术开发区国有资产管理办公室，为亦庄国投实际控制人
亦庄资本	指	北京亦庄资本控股有限公司，为亦庄国投股东
SSA、瑞典子公司	指	Silex Securities AB，注册在瑞典的公司，为赛莱克斯的全资子公司

SMI、美国子公司	指	Silex Microsystems Inc., 注册在美国的公司, 为赛莱克斯的全资子公司
SEB 银行、SEB	指	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 瑞典北欧斯安银行
耐威集思	指	耐威集思为耐威科技前身, 耐威科技系由北京耐威集思系统集成有限公司整体变更设立的股份有限公司
耐威时代	指	北京耐威时代科技有限公司
耐威智能	指	北京耐威智能科技有限公司
独立财务顾问、国信证券	指	国信证券股份有限公司
法律顾问、金杜律师事务所	指	北京市金杜律师事务所
德勤会计师、德勤会计师事务所	指	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
天圆全会计师、天圆全会计师事务所	指	北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
评估师、评估机构、天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
贸易企业 C	指	某一经国家军品出口主管部门批准的拥有武器装备综合进出口权的企业
《发行股份购买资产协议》	指	上市公司与瑞通芯源全体股东于 2015 年 12 月 30 日签署的《北京耐威科技股份有限公司与北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)、徐兴慧之发行股份购买资产协议》
《业绩承诺补偿协议》	指	上市公司与瑞通芯源全体股东于 2015 年 12 月 30 日签署的《北京耐威科技股份有限公司与北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)、徐兴慧之发行股份购买资产业绩承诺及补偿协议》
《股份认购协议》	指	上市公司分别与亦庄国投、周志文和杨云春于 2015 年 12 月 30 日签署的《附条件生效的股份认购协议》
《合伙协议》	指	《北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)之有限合伙协议》
《委托管理协议》	指	《北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)与北京盛世宏明投资基金管理有限公司之委托管理协议》
过渡期间	指	自本次交易的审计、评估基准日(不包括基准日当日)起至标的资产交割日(包括交割日当日)止的期间
交割日	指	本协议生效后, 将标的资产全部过户至上市公司名下, 并办理完成工商登记变更手续之日
审计、评估基准日	指	2015 年 8 月 31 日
承诺年度	指	2015 年度、2016 年度、2017 年度
最近三年	指	2013 年度、2014 年度、2015 年度
最近三年及一期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年度、2015 年 1-8 月
最近两年及一期	指	2014 年度、2015 年度、2015 年 1-8 月
报告期	指	2014 年度、2015 年度、2015 年 1-8 月
报告书、本报告书	指	《北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《证券发行暂行办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
适用意见第 12 号、适用意见	指	《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《募集资金管理办法》	指	《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》
《公司章程》	指	《北京耐威科技股份有限公司章程》
元、万元	指	如无特别说明，指人民币元、万元

二、专业术语

MEMS、微机电系统	指	Micro-Electronic-Mechanical System
集成电路、IC	指	Integrated Circuit，一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
Fabless	指	无晶圆厂，又称为IC设计商，指仅从事芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造外包给专业的晶圆代工厂的半导体公司
Fablite	指	轻晶圆厂，指在内部进行少量晶圆制造，而将更多的晶圆制造任务转交代工厂的半导体公司
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，整合器件制造商，又称为集成器件制造商，指自行进行芯片的设计、制造及封测，掌握芯片设计与生产制造工艺的半导体公司
超净车间	指	无尘室或清净室，作用在于控制产品（如硅芯片等）所接触之大气的洁净度日及温湿度，使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造
吋	指	英寸
pH 值	指	用以表示溶液酸性或碱性程度的数值，即所含氢离子浓度的常用对数的负值
μ m	指	微米，长度计量单位，相当于一米的百万分之一
nm	指	纳米，长度计量单位，相当于一米的十亿分之一
dB	指	分贝，是一种电信传输单位
Sol-Gel	指	溶胶凝胶
FGA	指	氮氢混合气体退火
杨氏模量	指	固体材料抵抗形变能力的物理量
热传导率	指	单位截面、长度的材料在单位温差下和单位时间内直接传导的热量
PZT	指	锆钛酸铅（Pb-based Lanthanum-doped Zirconate Titanates），是一种压电材料
BOM	指	Bill for Material，物料清单，是计算机可以识别的产品结构数据文件
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属

		氧化物半导体, 电压控制的一种放大器件, 是组成CMOS数字集成电路的基本单元
MOS	指	MOS指MOS管, MOS管实际上就是绝缘栅型场效应管, 全名叫Mosfet, 一般是金属(Metal)一氧化物(Oxide)一半导体(Semiconductor)场效应晶体管
GPS	指	Global Positioning System, 全球定位系统
IP	指	Intellegient Property, 专利技术, 是指被处于有效期内的专利所保护的技术
DRIE	指	Deep Reactive Ion Etching, 深反应离子刻蚀, 基于氟基气体的高深宽比的干法硅刻蚀技术, 同时使用物理与化学作用进行刻蚀。该技术不仅可将等离子体的产生和自偏压的产生分离, 而且采用了刻蚀和钝化交替进行的工艺, 实现对侧壁的保护, 能够实现可控的侧向刻蚀, 大大提高了刻蚀的各向异性特性, 是超大规模集成电路工艺中很有发展前景的一种刻蚀方法
Wafer bonding	指	晶圆键合技术, 将晶圆相互结合, 使表面原子相互反应, 产生共价键合, 让其表面间的键合能达到一定强度, 使晶片间无需媒介物而纯由原子键结为一体
Via	指	通孔技术, 使电路板中不同电路层之间连通的工艺
TSV	指	Through-Silicon-Via, 硅通孔技术
SilVia	指	赛莱克斯注册的硅通孔商标
MetVia	指	赛莱克斯注册的金属通孔商标
TGV	指	Through-Glass-Via, 玻璃通孔
KOH	指	氢氧化钾
HNA	指	酸性腐蚀液氢氟酸、硝酸和醋酸的混合液
DNA	指	Deoxyribose Nucleic Acid, 脱氧核糖核酸, 基因的组成部分
OIS	指	Optical Image Stabilization, 光学防抖
BAW	指	Bulk Acoustic Wave, 体声波
Capping	指	芯片封盖、圆片封盖密封
NPI	指	New Product Introduction, 新产品导入流程
RF MEMS	指	射频微机电系统, 运用MEMS技术加工的射频和微波频率电路器件产品
NRE	指	Non-Recurring Engeering, 即工艺开发, 指新产品开发过程中的一次性工程
3D	指	3 Dimensions的简称, 即是三维, 具有长、宽、高三维立体空间
Bosch	指	Robert Bosch GmbH, 中文称博世公司, 德国最大的工业企业之一, 从事汽车技术、工业技术和消费品及建筑技术的产业
Cisco	指	Cisco Systems, Inc. (思科公司), 成立于1984年12月, 是目前全球领先的网络解决方案供应商
STMicro	指	STMicroelectronics N.V., 中文称意法半导体公司, 是全球领先的半导体解决方案供应商
TI	指	Texas Instruments Inc., 中文称德州仪器, 为世界上最大的模拟电路技术部件制造商
TSMC	指	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, 中文称台湾积体电路制造公司, 是一家全球领先的半导体制造代工服务公司
IMT	指	Innovative Micro Technology Inc., 是美国最大的MEMS

		制造商之一
Honeywell	指	Honeywell International Inc., 中文称霍尼韦尔, 是一家多元化高科技和制造企业, 其业务涉及航空产品、楼宇、家庭、工业控制技术、汽车产品、涡轮增压器以及特殊材料等
InvenSense	指	InvenSense, Inc., 中文称应美盛股份有限公司, 为智能型运动处理方案的领导厂商
Teledyne Dalsa	指	Teledyne DALSA Inc., 是世界一流的高性能数字成像设备和半导体产品制造商
Global Foundries	指	GlobalFoundries Inc., 中文称格罗方德, 是一家由美国AMD公司分拆出来的半导体晶圆代工公司
SiTime	指	SiTime Corporation, 一家模拟半导体公司, 提供硅基MEMS谐振器
UMC	指	United Microelectronics Corporation, 中文称联华电子公司, 是世界著名的半导体承包制造商
Vanguard International	指	Vanguard International Semiconductor Corporation, 是一家提供集成电路定制服务的代工厂
Tronics	指	Tronics Microsystems SA, 位于法国的一家提供MEMS设计和MEMS代工服务的代工厂, 于2015年2月在法国巴黎证券交易所上市, 股票代码为“ALTRO.ENXTPA”
MagnaChip	指	MagnaChip Semiconductor Corporation, 前身为Hynix半导体公司的系统集成电路业务, 该公司开发、生产和分销系统集成电路芯片, 主要致力于显示驱动集成电路、CMOS影像传感器与应用解决方案处理器, 并经营代工厂业务, 于2011年3月在纽约证券交易所上市, 股票代码为“MX.N”
TowerJazz	指	Tower Semiconductor Ltd. 及其全资子公司Jazz Semiconductor Ltd.、TowerJazz Japan, Ltd., 是一家特种工艺晶圆代工厂
Tower International	指	Tower International Inc.
AMSAG	指	ams AG, 是一家位于奥地利的半导体制造商
Sensoror	指	Sensoror AS, 全球知名的陀螺和压力传感器供应商, 总部位于挪威
Imego	指	IMEGO AB (HK) CO., LIMITED, 瑞典MEMS惯性传感器、生物传感器、电磁传感器和集成系统研究机构IMEGO设在香港的贸易公司
GP	指	General Partner, 普通合伙人, 合伙企业的管理机构或自然人, 承担无限连带责任
LP	指	Limited Partner, 有限合伙人, 参与合伙企业投资的机构或自然人, 以其认缴的出资额为限承担有限责任

特别说明: 本报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异, 均因计算过程中的四舍五入所形成。

第一节 重大事项提示

特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

本部分所使用的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同涵义。

一、本次交易方案概述

(一) 购买瑞通芯源 100%股权

本次交易中，耐威科技拟以发行股份的方式购买北京集成电路投资中心、徐兴慧合计持有的瑞通芯源 100%的股权。

(二) 发行股份募集配套资金

耐威科技拟向亦庄国投、周志文和杨云春非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 74,972.04 万元，不超过本次交易总额（本次收购瑞通芯源 100%股权对价为 74,987.5028 万元）的 100%，扣除本次交易相关费用后拟用于标的公司建设北京 8 吋 MEMS 生产线。

耐威科技本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的履行及实施。

本次交易完成之后，耐威科技将直接持有瑞通芯源 100%的股权。本次交易完成后，耐威科技的实际控制人仍为杨云春先生，不会导致公司控制权发生变更。

二、本次交易标的资产价格

本次交易标的资产的价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告为基础确定。天健兴业采用资产基础法对标的资产进行评估，评估基准日为 2015 年 8 月 31 日。根据天健兴业出具的天兴评报字（2015）第 1269 号《评估报告》，截至 2015 年 8 月 31 日，标的资产瑞通芯源净资产账面价值为 48,984.36 万元，评估价值为 75,315.87 万元，增值额为 26,331.51 万元，增值率为 53.75%。

以上述评估值为参考依据，经上市公司与交易对方协商，最终标的资产交易价格为 74,987.5028 万元。

三、本次交易发行股份的价格、数量及锁定安排

(一) 发行股份价格

1、购买资产发行股份价格

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为耐威科技第二届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，计算方式为：

前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易的总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易的总量。

据此计算，公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 97.08 元/股，本次发行股份的价格为 87.38 元/股。最终发行价格尚需经公司股东大会审议通过并获中国证监会的核准。

2、配套融资发行股份价格

本次发行股份募集配套资金的发行价格为耐威科技第二届董事会第十四次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 87.38 元/股。最终发行价格尚需经公司股东大会审议通过并获中国证监会的核准。

3、发行股份价格调整方案

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

除此之外，公司董事会决议未设定其他发行价格调整方案。本次发行股份定价严格按照相关法律法规规定确定，反映了市场定价的原则，定价合理，有利于保护上市公司社会公众股东的合法权益。

(二) 发行股份数量

1、购买资产发行股份数量

本次交易支付的股份对价为 74,987.5028 万元，按照发行价格 87.38 元/股计算，对应的非公开发行股票的数量合计为 858.177 万股，最终的发行数量将以

拟购买资产成交价为依据，由公司董事会提请股东大会审议批准，并经中国证监会核准后确定。

2、配套融资发行股份数量

本次交易拟募集配套资金总额预计不超过 74,972.04 万元。按照发行价格 87.38 元/股计算，向亦庄国投、周志文和杨云春非公开发行股份数量不超过 858 万股。

3、合计发行股份数量

本次交易中，上市公司预计将合计发行 1,716.177 万股股份，占交易完成后公司总股本的 16.9647%，具体情况如下：

单位：万股

发行对象/认购人	发行数量	占交易完成后总股本比例
北京集成电路投资中心	857.3188	8.4747%
徐兴慧	0.8582	0.0085%
亦庄国投	686.0000	6.7812%
周志文	114.0000	1.1269%
杨云春	58.0000	0.5733%
合计	1,716.1770	16.9647%

在本次发行股份购买资产之定价基准日至发行日期间，上市公司如有发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权行为，发行数量亦作相应调整。

（三）股份锁定安排

1、购买资产发行股份的锁定期

根据《重组管理办法》的规定，北京集成电路投资中心、徐兴慧通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。

上述新增股份发行完毕至上述锁定期届满之日止，北京集成电路投资中心、徐兴慧由于耐威科技送红股、资本公积转增股本等原因增持的耐威科技股份，亦应遵守上述承诺。

2、募集配套资金发行股份的锁定期

根据《重组管理办法》的规定，亦庄国投、周志文和杨云春通过本次配套融资所取得的上市公司非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。

上述认购的股份发行完毕至上述锁定期届满之日止，亦庄国投、周志文和杨

云春由于耐威科技送红股、资本公积转增股本等原因增持的耐威科技股份，亦应遵守上述承诺。

四、业绩承诺和业绩补偿

(一) 业绩承诺

北京集成电路投资中心及徐兴慧承诺，赛莱克斯 2015 年、2016 年、2017 年的承诺净利润分别为 3,333.90 万瑞典克朗、3,799.80 万瑞典克朗、5,664.50 万瑞典克朗，三年累计承诺净利润合计数不低于 12,798.2 万瑞典克朗。

承诺净利润指赛莱克斯 2015 年、2016 年、2017 年实现的经调整后的扣除非经营性损益后的净利润，包括计入当期损益的欧洲及瑞典的政府补助，但不包括计入当期损益的股权交易相关费用。具体计算公式为：经调整后的扣除非经营性损益后的净利润=扣除非经常性损益后的净利润+计入当期损益的欧洲及瑞典的政府补助+计入当期损益的股权交易相关费用的绝对值。

(二) 业绩承诺差额的确定

承诺年度期满后，上市公司应当聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所 在承诺年度结束后的 3 个月内对赛莱克斯在承诺年度内累计实现的承诺净利润情况出具专项审核意见。

(三) 补偿义务

承诺年度期满后，如果赛莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润高于或等于承诺净利润合计数的 95%，则北京集成电路投资中心、徐兴慧无需进行补偿；如果赛莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润低于承诺净利润数的 95%，则北京集成电路投资中心、徐兴慧需向上市公司支付股票补偿，支付股票补偿的公式为：

北京集成电路投资中心、徐兴慧合计需补偿的股票数量=（1－赛莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润÷承诺净利润合计数）×本次交易上市公司向北京集成电路投资中心、徐兴慧发行的股票总数

北京集成电路投资中心、徐兴慧需补偿的股票数量不超过其在本次交易中获得的全部股票总数的 30%。

如上市公司在承诺年度内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数相应调整为：补偿股份数（调整后）=应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。

如上市公司在承诺年度内实施现金分配的, 现金分配的部分应作相应返还, 计算公式为: 返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×应补偿股份数。

北京集成电路投资中心、徐兴慧之间按照其在本交易前持有的瑞通芯源的股权比例计算各自应当补偿股份数。

如发生上述应回购股份的情形, 上市公司应当在具有证券期货从业资格的会计师事务所对赛莱克斯在承诺年度内累计实现的承诺净利润情况出具专项审核意见之日起 10 个交易日内, 计算应回购的股份数量并以书面方式通知北京集成电路投资中心、徐兴慧累计实现的承诺净利润数小于承诺净利润合计数情况以及应补偿股份数量。

北京集成电路投资中心、徐兴慧应在收到上述书面通知之日起 10 个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将其需补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户。同时, 上市公司应当发出召开上市公司董事会和股东大会的通知, 经股东大会审议通过, 将由上市公司按照人民币 1 元的总价回购该等补偿的股份并按照有关法律规定予以注销, 并以书面方式通知北京集成电路投资中心、徐兴慧。如果上市公司股东大会未通过, 上市公司应在股东大会决议公告后 10 个工作日内书面通知北京集成电路投资中心、徐兴慧, 北京集成电路投资中心、徐兴慧应在收到上述书面通知后 2 个月内将应补偿股份无偿划转给上市公司赠送股份实施公告中确认的股权登记日在册的上市公司股东, 股东按其持有的股份数量占总股本的比例获赠股份。

五、目标公司赛莱克斯剩余 2%股权的安排

本次交易完成后, 上市公司将间接持有目标公司赛莱克斯 98%的股权, 赛莱克斯剩余 2%的股权仍由其首席执行官 Edvard Kälvesten 持有。

2015 年 7 月 13 日, 赛莱克斯、运通电子及 Edvard Kälvesten 签订《股东协议》, 根据《股东协议》及《发行股份购买资产协议》, 就 Edvard Kälvesten 持有的赛莱克斯 2%股权的出售安排约定如下:

(一) 第一期出售及购买

在本次交易完成后, 运通电子或其关联方将立即按照每股 87.17 瑞典克朗的价格收购 Edvard Kälvesten 持有的赛莱克斯 1%的股权, 且本次收购完成时间不得晚于 2016 年 7 月 13 日。

(二) 第二期出售及购买

在 2016 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日期间, Edvard Kälvesten 有权向运通电子出售且运通电子及其关联方有权向 Edvard Kälvesten 购买其持有的赛莱克斯剩余 1%股权, 每股作价为 87.17 瑞典克朗加上利息, 利息的年利率为 5%, 利息计算期间为自 2015 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 13 日或该等股权出售之日(以较早日期为准)。

本次交易完成后, 运通电子或其关联方将按照上述约定收购 Edvard Kälvesten 持有的赛莱克斯剩余 1%股权, 具体收购主体和收购方案由耐威科技和 Edvard Kälvesten 另行协商确定。

六、本次交易构成重大资产重组

截至 2014 年 12 月 31 日, 上市公司经审计的合并资产总额为 39,436.25 万元, 合并归属于母公司所有者权益为 26,370.12 万元。本次交易拟购买的标的资产交易价格为 74,987.5028 万元, 占上市公司近一个会计年度合并资产总额的比例为 190.15%, 超过 50%; 占上市公司最近一个会计年度合并归属于母公司所有者权益的比例为 284.37%, 且交易金额超过 5,000 万元。综上所述, 本次交易满足《重组管理办法》第十二条对于构成重大资产重组标准的要求。因此, 本次交易构成重大资产重组。

七、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方为北京集成电路投资中心、徐兴慧, 募集配套资金的认购对象为亦庄国投、周志文和杨云春。

本次交易前, 交易对方北京集成电路投资中心、徐兴慧与上市公司之间不存在关联关系及关联交易。本次交易完成后, 北京集成电路投资中心持有上市公司 8.47%的股份, 根据《上市规则》, 北京集成电路投资中心为上市公司潜在关联方。本次募集配套资金的认购对象之一亦庄国投拟认购上市公司 6.78%的股份, 根据《上市规则》, 亦庄国投为上市公司潜在关联方。上市公司与以上潜在关联方之间的交易构成关联交易。

本次交易前, 募集配套资金的认购对象之一杨云春持有公司 55.73%的股份, 为上市公司控股股东、实际控制人。因此, 本次募集配套资金系本公司与控股股

东之间的交易，构成关联交易，上市公司在召集董事会、股东大会审议相关议案时，关联董事、关联股东杨云春将回避表决。

八、本次交易不构成借壳上市

本次交易前，公司总股本为 8,400 万股，杨云春先生持有公司 4,681.0907 万股股份，占公司总股份的 55.73%，为公司的控股股东及实际控制人。本次交易中，公司预计将发行 1,716.177 万股股份，发行完成后，公司总股份将增至 10,116.177 万股，杨云春先生持有公司股份比例将降至 46.85%，公司控股股东及实际控制人仍为杨云春先生。

本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不构成借壳上市。

九、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对公司股权结构及控制权的影响

本次交易前，公司总股本为 8,400 万股。本次交易中，公司预计将发行 1,716.177 万股股份，发行完成后，公司总股份将增至 10,116.177 万股。本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

单位：万股

序号	股东名称	本次交易之前		本次交易之后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	杨云春	4,681.0907	55.73%	4,739.0907	46.85%
2	北京集成电路投资中心	-	-	857.3188	8.47%
3	徐兴慧	-	-	0.8582	0.01%
4	亦庄国投	-	-	686.0000	6.78%
5	周志文	-	-	114.0000	1.13%
6	其他股东	3,718.9093	44.27%	3,718.9093	36.76%
合计		8,400.00	100.00%	10,116.1770	100.00%

注：本次交易前后的股东持股情况系根据截至 2015 年 8 月 3 日（因拟披露重大事项停牌日）公司登记在册的股东持股数据，结合本次交易预计增加股份数量计算。

本次交易前，杨云春先生持有公司 4,681.0907 万股股份，占公司总股份的 55.73%，为公司的控股股东及实际控制人。本次交易完成后，杨云春先生持有公司股份的比例将降至 46.85%，公司控股股东及实际控制人仍为杨云春先生。本次交易未导致公司控制权发生变化。

本次交易完成后，耐威科技的股本总额为 10,116.177 万股，社会公众股占

本次发行后上市公司股本总额的比例不低于 25%，满足股票上市条件

(二) 本次交易对上市公司主要财务数据和财务指标的影响

公司按照本次交易完成后的架构编制了最近一年一期的备考合并财务报表，并已经天圆全会计师事务所审阅。根据上市公司 2014 年经审计财务报告、2015 年 1-8 月经审阅的财务报告以及天圆全阅字[2015]000004 号备考财务报告，本次交易前后，公司最近一年一期主要财务数据、财务指标及变动情况如下：

期间	项目	实现数	备考数	变动率
2014 年 度 /2014 年末	资产总额（万元）	39,436.25	125,936.03	219.34%
	负债总额（万元）	12,494.57	24,809.48	98.56%
	归属于母公司所有者权益（万元）	26,370.12	100,165.82	279.85%
	每股净资产（元/股）	4.19	13.99	233.89%
	资产负债率	31.68%	19.70%	-37.82%
	营业收入（万元）	16,939.10	37,407.49	120.84%
	营业利润（万元）	4,974.84	4,631.28	-6.91%
	利润总额（万元）	6,139.49	7,917.45	28.96%
	净利润（万元）	5,485.91	6,521.06	18.87%
	归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,394.33	6,408.77	18.81%
	基本每股收益（元/股）	0.86	0.90	4.65%
2015 年 1-8 月/2015 年 8 月末	资产总额（万元）	62,028.92	144,926.15	133.64%
	负债总额（万元）	6,819.11	14,315.84	109.94%
	归属于母公司所有者权益（万元）	54,640.97	129,628.47	137.24%
	每股净资产（元/股）	7.71	16.31	111.54%
	资产负债率	10.99%	9.88%	-10.10%
	营业收入（万元）	7,415.23	21,518.21	190.19%
	营业利润（万元）	765.89	1,151.66	50.37%
	利润总额（万元）	1,909.10	2,796.78	46.50%
	净利润（万元）	1,697.62	2,751.24	62.06%
	归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,653.84	2,685.87	62.40%
	基本每股收益（元/股）	0.23	0.34	47.83%

本次交易完成后上市公司总资产规模、净资产规模、营业收入规模、净利润水平均有明显增加，基本每股收益有所增加。本次交易完成后上市公司不存在因并购重组交易而导致当期每股收益被摊薄的情况。

十、本次交易的决策过程

(一) 本次交易已履行的决策过程

1、上市公司的决策过程

2015年8月3日,因拟披露重大事项,公司股票于开市时起实施临时停牌;
2015年8月4日,因筹划重大资产重组事项,公司股票于开市时起继续停牌。

2015年11月2日,经第二届董事会第十一次会议审议通过并经深交所同意,公司股票继续停牌。

2015年12月30日,公司与北京集成电路投资中心、徐兴慧签署《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》。

2015年12月30日,公司与亦庄国投、周志文和杨云春分别签署了《股份认购协议》。

2015年12月30日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过本次交易相关议案。

2、交易对方的决策过程

2015年8月26日,北京集成电路投资中心投资决策委员会审议通过了《关于Epton项目本基金向上市公司出售亦庄公司股权的决议》,同意拟向耐威科技出售北京集成电路投资中心所持有的瑞通芯源99.9%的股权。

3、标的公司的决策过程

2015年12月25日,瑞通芯源召开股东会,审议通过北京集成电路投资中心及徐兴慧将其持有的瑞通芯源股权转让给耐威科技的事项;徐兴慧同意放弃对北京集成电路投资中心所拥有的瑞通芯源股权的优先购买权,北京集成电路投资中心同意放弃对徐兴慧所拥有的瑞通芯源股权的优先购买权。

(二) 本次交易尚需履行的审批程序

本次交易已由上市公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚需履行以下批准程序:

(1) 上市公司股东大会审议通过本次交易;

(2) 亦庄国投的国资主管部门审批通过亦庄国投参与认购上市公司非公开发行股票事宜;

(3) 中国证监会核准本次交易。

本次交易能否获得上述通过或核准及获得上述通过或核准的时间存在不确定性。公司提请广大投资者注意投资风险。

十一、本次交易相关方所作出的重要承诺

(一) 关于提供资料真实、准确、完整的承诺

承诺主体类别	承诺主体	承诺内容
上市公司	上市公司全体董事、监事、高级管理人员	1、本人已向耐威科技及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重大资产重组事宜在现阶段所必须的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致的和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 2、根据本次重大资产重组的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 3、本人承诺并保证为本次重大资产重组所提供的信息和文件真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 4、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在耐威科技拥有权益的股份。
交易对方	北京集成电路投资中心、徐兴慧	1、本企业/本人已向耐威科技及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重大资产重组事宜在现阶段必须的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或书面陈述和说明，不存在任何虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致的和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有书面陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 2、根据本次重大资产重组的进程，本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向耐威科技提供本次重大资产重组相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 3、如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈

		述或者重大遗漏，给耐威科技或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业/本人将暂停转让在耐威科技拥有权益的股份。
配套资金方	亦庄国投 周志文 杨云春	1、本公司/本人/本人/本人已向耐威科技及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重大资产重组事宜在现阶段必须的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或书面陈述和说明，不存在任何虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致的和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有书面陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 2、根据本次重大资产重组的进程，本公司/本人/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向耐威科技提供本次重大资产重组相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 3、如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给耐威科技或者投资者造成损失的，本公司/本人/本人将依法承担赔偿责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本人/本人将暂停转让在耐威科技拥有权益的股份。

(二) 关于持有标的公司股权合法、完整、有效性的承诺

承诺主体类别	承诺主体	承诺内容
交易对方	北京集成电路投资中心 徐兴慧	1、本企业/本人作为瑞通芯源的股东，已经依法履行对瑞通芯源出资人民币 489,570,652.94/500,000 元的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为瑞通芯源股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响瑞通芯源合法存续的情况。 2、本企业/本人所持有的瑞通芯源股权为本企业/本人实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。

(三) 关于股份锁定期的承诺

承诺主体类别	承诺主体	承诺内容
交易对方	北京集成电路投资中心 徐兴慧	1、本企业/本人通过本次重组获得的耐威科技的新增股份,自该等新增股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让。 2、上述新增股份发行完毕至上述锁定期届满之日止,本企业/本人由于耐威科技送红股、资本公积转增股本等原因增持的耐威科技股份,亦应遵守上述承诺。 3、上述锁定期满后,本企业/本人持有的新增股份将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定进行转让。
配套资金方	亦庄国投 杨云春 周志文	1、自本次发行结束之日起 36 个月内,本公司/本人/本人不以任何方式转让本公司/本人/本人在本次发行中认购的耐威科技的股份。 2、上述认购的股份发行完毕至上述锁定期届满之日止,本公司/本人/本人由于耐威科技送红股、资本公积转增股本等原因增持的耐威科技股份,亦应遵守上述承诺。 3、上述锁定期满后,本公司/本人/本人认购的股份将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定进行转让。

(四) 关于无关联关系的承诺

承诺主体类别	承诺主体	承诺内容
配套资金方	亦庄国投	1、本次交易前,本公司及本公司全体股东、实际控制人与耐威科技及其关联方均不存在关联关系。本公司与耐威科技之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系,本公司没有向耐威科技推荐董事、监事或者高级管理人员,与耐威科技的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系、关联关系,本公司亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定为与耐威科技存在特殊关系的其他关联关系。 2、本公司认购耐威科技本次非公开发行股份募集配套资金之认购价款均系自有资金,不存在向耐威科技及其控股股东、董事、监事、高级管理人员借款的情形,亦未针对本次交易进行结构性融资。
	周志文	本次交易前,本人与耐威科技及其关联方均不存在关联关系。本人与耐威科技之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系,本人没有向耐威科技推荐董事、监事或者高级管理人员,与耐威科技的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系、关联关系,本人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定为与耐威科技存在特殊关系的其他关联关系。

(五) 关于避免同业竞争的承诺

承诺主体类别	承诺主体	承诺内容
交易对方	北京集成电路投资中心 徐兴慧	1、截至本承诺函出具之日，除本企业/本人作为投资人而进行的投资外，本企业/本人未直接从事任何在商业上对耐威科技或其所控制的企业构成同业竞争的业务或活动，并保证在本企业/本人持有耐威科技股票期间也不会直接从事任何在商业上对耐威科技或其所控制的企业构成同业竞争的业务或活动（本企业/本人作为投资人而进行的投资除外）。 2、在本次交易完成后，除本企业/本人作为投资人而进行的投资外，在本企业/本人持有耐威科技股票期间，如本企业/本人直接从事的业务与耐威科技及其下属企业经营的业务产生竞争，则本企业/本人将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入耐威科技或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业/本人不再直接从事与耐威科技及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。 3、如因本企业/本人违反上述承诺而给耐威科技造成损失的，本企业/本人将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本企业/本人承诺以现金方式支付上述损失。 4、本承诺在本企业/本人作为耐威科技股东期间持续有效且不可变更或撤销。
配套资金方	亦庄国投	1、截至本承诺函出具之日，除本公司作为投资人而进行的投资外，本公司未直接从事任何在商业上对耐威科技或其所控制的企业构成同业竞争的业务或活动，并保证在本公司持有耐威科技股票期间也不会直接从事任何在商业上对耐威科技或其所控制的企业构成同业竞争的业务或活动（本公司作为投资人而进行的投资除外）。 2、在本次交易完成后，除本公司作为投资人而进行的投资外，在本企业持有耐威科技股票期间，如本公司直接从事的业务与耐威科技及其下属企业经营的业务产生竞争，则本公司将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入耐威科技或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司不再直接从事与耐威科技及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。 3、如因本公司违反上述承诺而给耐威科技造成损失的，本公司将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本公司承诺以现金方式支付上述损失。 4、本承诺在本公司作为耐威科技股东期间持续有效且不可变更或撤销。
配套资金方	周志文	1、截至本承诺函出具之日，本人未从事任何在商业上对耐威科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何在商业上对耐威科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务

		或活动。 2、本次交易完成后,在本人持有耐威科技股票期间,如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围,与耐威科技及其下属企业经营的业务产生竞争,则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入耐威科技或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使本人及本人控制的企业不再从事与耐威科技及其下属企业主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。 3、如因本人违反上述承诺而给耐威科技造成损失的,本人将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内,本人承诺以现金方式支付上述损失。 4、本承诺在本人作为耐威科技股东期间持续有效且不可变更或撤销。
上市公司实际控制人	杨云春	1、截至本承诺函出具之日,本人未从事任何在商业上对耐威科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何在商业上对耐威科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。 2、本次交易完成后,在本人持有耐威科技股票期间,如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围,与耐威科技及其下属企业经营的业务产生竞争,则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入耐威科技或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使本人及本人控制的企业不再从事与耐威科技及其下属企业主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。 3、如因本人违反上述承诺而给耐威科技造成损失的,本人将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内,本人承诺以现金方式支付上述损失。 4、本承诺在本人作为耐威科技股东期间持续有效且不可变更或撤销。

(六) 关于减少和规范关联交易的承诺

承诺主体类别	承诺主体	承诺内容
交易对方	北京集成电路投资中心 徐兴慧	1、截至本承诺函出具之日，本企业/本人及相关关联方不存在与耐威科技及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本企业/本人将会严格遵守有关上市公司监管法规，规范和减少与耐威科技及其所控制企业之间的关联交易；若本企业/本人及相关关联方与耐威科技及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本企业/本人及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在耐威科技履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保耐威科技及其股东的利益不受损害。 2、如因本企业/本人违反上述承诺而给耐威科技造成损失的，本企业/本人将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本企业/本人承诺以现金方式支付上述损失。
配套资金方	亦庄国投 周志文	1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人及相关关联方不存在与耐威科技及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本公司/本人将会严格遵守有关上市公司监管法规，规范和减少与耐威科技及其所控制企业之间的关联交易；若本公司/本人及相关关联方与耐威科技及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本公司/本人及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在耐威科技履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保耐威科技及其股东的利益不受损害。 2、如因本公司/本人违反上述承诺而给耐威科技造成损失的，本公司/本人将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本公司/本人承诺以现金方式支付上述损失。
上市公司实际控制人	杨云春	1、截至本承诺函出具之日，本人及相关关联方不存在与耐威科技及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本人将会严格遵守有关上市公司监管法规，规范和减少与耐威科技及其所控制企业之间的关联交易；若本人及相关关联方与耐威科技及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本人及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在耐威科技履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保耐威科技及其股东的利益不受损害。 2、如因本人违反上述承诺而给耐威科技造成损失的，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。

(七) 关于保持上市公司独立性的承诺

承诺主体类别	承诺主体	承诺内容
交易对方	北京集成电路投资中心 徐兴慧	在本次交易完成后,本企业/本人承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与耐威科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响耐威科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害耐威科技及其他股东的利益,切实保障耐威科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。
配套资金方	亦庄国投 周志文	在本次交易完成后,本公司/本人承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与耐威科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响耐威科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害耐威科技及其他股东的利益,切实保障耐威科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。
上市公司实际控制人	杨云春	在本次交易完成后,本人承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与耐威科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响耐威科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害耐威科技及其他股东的利益,切实保障耐威科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。

(八) 关于不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚的声明和承诺

承诺主体类别	承诺主体	承诺内容
交易对方	北京集成电路投资中心 徐兴慧	1、本企业及主要管理人员/本人最近五年不存在负有数额较大债务到期未清偿、未履行承诺; 2、本企业及主要管理人员/本人不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或行政处罚,以及受到证券交易所纪律处分或公开谴责的情况; 3、本企业及主要管理人员/本人不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为以及因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之情形; 4、本企业及主要管理人员/本人不存在任何证券市场失信行为; 5、本企业及主要管理人员/本人最近五年均未受到过刑事处罚、与证券市场有关的行政处罚、或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼及仲裁的情形。
配套资金方	亦庄国投 周志文 杨云春	1、本公司及主要管理人员/本人最近五年不存在负有数额较大债务到期未清偿、未履行承诺; 2、本公司及主要管理人员/本人不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或行政处罚,以及受到证券交易所纪律处分或公开谴责的情况; 3、本公司及主要管理人员/本人不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为以及因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之情形;

		4、本公司及主要管理人员/本人不存在任何证券市场失信行为; 5、本公司及主要管理人员/本人最近五年均未受到过刑事处罚、与证券市场有关的行政处罚、或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼及仲裁的情形。
--	--	---

(九) 关于上市公司最近三年合法合规的承诺

承诺主体类别	承诺主体	承诺内容
上市公司	上市公司及其现任董事、高级管理人员	1、最近三年内, 本公司/本人/本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 2、最近三年内, 本公司/本人/本人未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚。 3、最近十二个月内, 本公司/本人/本人未受到过证券交易所公开谴责。

十二、本次交易中对中小投资者权益保护的安排

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)的规定, 上市公司在本次交易中对中小投资者的权益保护方面做出了恰当的安排, 具体情况如下:

(一) 严格履行上市公司信息披露义务

上市公司及相关信息披露人严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》、《重组若干规定》等相关法律、法规的要求对本次重组方案采取严格的保密措施, 切实履行信息披露义务, 公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后, 本公司将继续严格按照相关法律法规的要求, 及时、准确地披露本次重组的进展情况。

(二) 股东大会、网络投票安排及关联方回避表决

根据《重组管理办法》等有关规定, 公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告, 提醒股东参加审议本次交易方案的股东大会。公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定, 为参加股东大会的股东提供便利, 除现场投票外, 公司将就本次交易方案的表决提供网络投票平台, 股东可以直接通过网络进行投票表决。

根据中国证监会相关规定, 本次交易将在股东大会审议时进行网络投票, 并单独统计和列示中小股东的表决情况。

根据《上市规则》, 本次交易构成关联交易, 因此, 上市公司在召开董事会、

股东大会审议相关议案时，关联方需回避表决相关议案。

（三）资产定价的公允性

本次交易所涉及的标的资产系以具有从事证券期货业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》为作价依据，上市公司独立董事就天健兴业评估的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的合理性、交易价格的公允性发表了独立意见，认为评估机构独立、评估假设前提合理，评估方法合理、交易价格公允。因此，本次交易所涉及的标的资产定价程序完备，定价公允，不存在损害上市公司和中小股东合法权益的情形。

（四）本次交易对每股收益的影响

通过本次交易，瑞通芯源将成为上市公司全资子公司，纳入合并报表范围。根据天圆全会计师事务所出具的天圆全审字[2015]000004 号《备考审阅报告》，重组完成后上市公司 2015 年 1-8 月基本每股收益为 0.34 元，较重组完成前上市公司 2015 年 1-8 月每股收益 0.23 元有所提高，本次交易完成后将增厚上市公司的每股收益。

（五）聘请具备相关从业资格的中介机构

公司聘请了具有专业资格的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构，对本次重组方案及全过程进行监督并出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

十三、独立财务顾问的保荐资格

本公司聘请国信证券担任本次交易的独立财务顾问，国信证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐人资格。

第二节 特别风险提示

一、与本次交易相关的风险

(一) 本次交易无法获得批准的风险

本次交易已由上市公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚需履行以下批准程序:

(1) 上市公司股东大会审议通过本次交易;

(2) 亦庄国投的国资主管部门审批通过亦庄国投参与认购上市公司非公开发行股票事宜;

(3) 中国证监会核准本次交易。

本次交易能否获得上述通过或核准及获得上述通过或核准的时间存在不确定性。公司提请广大投资者注意投资风险。

(二) 交易终止的风险

公司在本次与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围,减少内幕信息的传播,但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为,公司存在因股价异常波动或存在异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、终止或取消本次交易的风险。

此外,本次交易方案尚需获得上市公司股东大会审议通过以及中国证监会核准,从签署协议到完成交易需要一定时间。在交易推进过程中,市场情况可能会发生变化,从而影响本次交易的条件;在本次交易审核过程中,监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止或取消的可能。公司提请投资者关注本次交易可能终止或取消的风险。

(三) 交易标的估值风险

本次交易标的资产的价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告为基础确定。天健兴业采用资产基础法对标的资产进行评估,评估基准日为2015年8月31日。根据天健兴业出具的天兴评报字(2015)第1269号《评估报告》,截至2015年8月31日,标的资产瑞通芯源净资产账面价值为48,984.36

万元,评估价值为 75,315.87 万元,增值额为 26,331.51 万元,增值率为 53.75%。以上述评估值为参考依据,经交易双方协商确定,瑞通芯源 100%股权作价 74,987.5028 万元。

本次交易标的瑞通芯源 100%股权的估值增值主要是来自于长期股权投资的评估增值,瑞通芯源通过全资子公司运通电子间接持有赛莱克斯 98%的股权。赛莱克斯的评估采用了收益法及资产基础法两种方法,最终以收益法评估结果作为评估结论。赛莱克斯的估值较账面净资产增值较高,主要是由于赛莱克斯作为全球领先的纯 MEMS 代工企业,盈利能力主要依托于其覆盖 MEMS 各终端领域的全面的工艺技术储备、专利技术和技术平台、高素质和具有丰富 MEMS 芯片制造经验的员工队伍、国际知名客户资源、科学的 MEMS 代工厂管理经验等不可辨认的无形资产(资源),而上述无形资产(资源)在创建和取得过程中的支出在财务核算中大部分已作费用化处理,但该等无形资产(资源)未来对利润的贡献价值远大于其创建和取得成本,故交易标的的评估结果与股东权益账面值相比有较大增值。

收益法是从企业未来获利能力角度考虑其价值,能够更好地反映标的公司的综合获利能力。虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉尽责的职责,但仍存在因未来实际情况与评估假设不一致,未来盈利达不到资产评估时的预测,导致出现目标公司估值与实际情况不符的情形。

(四) 承诺业绩无法实现的风险

根据公司与制造和装备股权投资中心、徐兴慧签署的《发行股份购买资产协议》,北京集成电路投资中心及徐兴慧承诺,赛莱克斯 2015 年、2016 年、2017 年的承诺净利润分别为 3,333.9 万瑞典克朗、3,799.8 万瑞典克朗及 5,664.5 万瑞典克朗,三年累计承诺净利润合计数不低于 12,798.2 万瑞典克朗。承诺净利润指赛莱克斯公司 2015 年、2016 年、2017 年实现的经调整后的扣除非经营性损益后的净利润,包括计入当期损益的欧洲及瑞典的政府补助,但不包括计入当期损益的股权交易相关费用。具体计算公式为:经调整后的扣除非经营性损益后的净利润=扣除非经常性损益后的净利润+计入当期损益的欧洲及瑞典的政府补助+计入当期损益的股权交易相关费用的绝对值。

承诺年度期满后,如果赛莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润高于或等于承诺的净利润数的 95%,则北京集成电路投资中心、徐兴慧无需进行补偿;如

果赛莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润低于承诺净利润数的 95%，则北京集成电路投资中心、徐兴慧应按照约定履行股份补偿义务，但北京集成电路投资中心、徐兴慧需补偿的股票数量不超过其在本本次交易中获得的全部股票总数的 30%。

承担补偿义务的交易对方将勤勉经营，尽最大努力确保上述业绩承诺实现。但可能由于宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧，以及赛莱克斯不能根据市场潮流变化及时推出新工艺、新技术以保持自身竞争优势等多种原因可能导致业绩无法达到预期的风险。尽管《发行股份购买资产协议》约定的业绩补偿方案可以较大程度地保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果标的公司在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，则会影响到上市公司的整体经营业绩和盈利规模。

（五）业绩补偿不足的风险

本次交易系上市公司拟以发行股份的方式购买北京集成电路投资中心、徐兴慧合计持有的瑞通芯源 100%的股权。交易双方约定如目标公司赛莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润低于承诺净利润数的 95%，交易对方应以股票方式对上市公司进行补偿。经交易双方谈判，在充分考虑交易对方对目标公司未来经营的作用、未来承担的业绩补偿责任和风险、取得目标公司时间和价格以及股份锁定期的基础上，上市公司与交易对方约定了股票补偿的最高限额，北京集成电路投资中心及徐兴慧需补偿股票数量的最高限额不超过其于本次交易获得的上市公司股票总数的 30%。若目标公司赛莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润低于承诺净利润数的 95%，则各交易对方在向上市公司支付其股票补偿最高限额的补偿后，无须再对上市公司进行额外的股票或现金补偿。提醒投资者关注相关业绩补偿不足的风险。

（六）本次交易与目标公司近期股权转让价格差异较大的风险

标的资产瑞通芯源及其子公司运通电子为控股型公司，瑞通芯源集团内的业务经营实体为目标公司赛莱克斯，瑞通芯源通过运通电子间接持有赛莱克斯 98%的股权。2015 年 6 月 15 日，运通电子与 Northzone Ventures 等 37 位股东签署《股份转让协议》，受让赛莱克斯公司 98%的股权，2015 年 7 月 13 日办理完毕股份交割手续。根据股份转让协议，该次股权转让价格为 66,150 万瑞典克朗(按购汇汇率计算，折合人民币约 48,957.07 万元)。本次交易中，以目标公司赛莱克

斯的评估值为基础,瑞通芯源 100%股权的交易价格为 74,987.5028 万元,较前次交易增值金额较大。

本次交易是上市公司基于产业布局和业务协同效应的目的,以 2015 年 8 月 31 日为基准日,由具有证券期货相关业务资格的评估机构分别采用收益法及资产法对赛莱克斯进行评估,最终选取收益法评估结果作为赛莱克斯的评估值,并以赛莱克斯评估值为基础确定瑞通芯源的估值,最终由交易双方参考评估值协商确定交易价格。前次交易(运通电子收购赛莱克斯 98%股权的交易)是基于产业并购基金模式,以 2015 年初的市场行情,参考国际同行业公司市场价值协商确定交易价格。因交易的目的、估值的方法、估值时间点及支付方式均不同,导致本次交易与目标公司前次股权转让价格存在较大差异,提请广大投资者注意投资风险。

(七) 募集配套资金失败或融资金额低于预期的风险

本次募集配套资金扣除交易相关费用后拟全部用于标的公司建设北京 8 吋 MEMS 生产线。瑞通芯源通过间接控制全球领先的 MEMS 代工厂赛莱克斯,同时引进和借鉴国外成熟先进的制造工艺、技术平台和生产管理体系等方式,在北京建设一条 8 吋 MEMS 代工生产线和完整的代工服务体系,以承接赛莱克斯的部分成熟产品线和工艺技术,在国内开展大批量成熟 MEMS 芯片产品的代工业务,同时解决赛莱克斯无法满足大批量成熟 MEMS 芯片产品代工生产的困境。

本次交易中,耐威科技拟向亦庄国投、周志文和杨云春非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过 74,972.04 万元,不超过本次交易总额(本次收购瑞通芯源 100%股权对价为 74,987.5028 万元)的 100%。

受股票市场波动及投资者预期的影响,募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。此外,本次交易配套募集资金存在未获证监会核准通过或者获批后融资金额低于预期的可能。公司将面临募集配套资金失败或融资金额低于预期的风险。在募集配套资金失败或融资金额低于预期的情形下,公司将通过自筹或其他形式支付该部分投资款。如果债务融资等其他融资形式的资金成本高于本次股权配套融资,则可能会削弱本次交易对上市公司盈利的增厚效果。

(八) 资产租赁风险

目标公司赛莱克斯为集成电路晶圆制造厂,即 MEMS 代工厂,需要巨资投资设备和加工工艺,为有效安排生产及运用资金,缓解高投资压力,赛莱克斯的部

分机器设备系以融资租赁方式取得。截至 2015 年 8 月 31 日,赛莱克斯正在履行的融资租赁合同共 14 项,预计购买价格合计 4,972.06 万元。根据融资租赁合同约定,出租方 SEB 银行在融资租赁期间内拥有租赁物的所有权。如果赛莱克斯在租赁期内出现未按照合同约定支付租金等违约情况,SEB 银行可以提前终止合同,无需司法程序即取回或禁止赛莱克斯使用租赁物,并要求赛莱克斯赔偿 SEB 银行因此受到的一切损失。故如未来赛莱克斯发生违约,导致上述租赁设备被提前收回,赛莱克斯的生产经营将受到影响。

赛莱克斯的生产经营场所及办公场所系以经营租赁方式取得,出租方拥有相关资产的完整权属。赛莱克斯自与出租方建立生产经营场所及办公场所的租赁关系以来,双方均严格履行租赁协议约定,不存在违约情形,但仍不能完全排除在租赁期届满后租赁双方未达成续租协议或出租方未能履行租赁协议之义务,而赛莱克斯未能及时重新选择经营场所的情形,从而对赛莱克斯的经营造成影响的可能性。

二、本次交易完成后的风险

(一) 整合风险

本次交易完成后,瑞通芯源将成为上市公司的全资子公司,上市公司将通过瑞通芯源间接控股全球领先的 MEMS 芯片制造企业赛莱克斯。通过以上布局,一方面,上市公司可沿着惯性导航系统—惯性导航产品—惯性传感器产业链向上游延伸,进入与传感器相关的 MEMS 芯片开发与制造业务,有利于提升上市公司在 MEMS 传感器领域的基础开发能力和新产品研发能力;另一方面,上市公司立足现有导航定位产业的基础上,通过收购 MEMS 芯片制造厂来实现由“定位”拓展到“感知”领域,开拓物联网等新业务。本次交易不仅有助于发挥双方的协同效应,也有利于提升公司的资产质量,增强公司的抗风险能力。为发挥标的公司的竞争优势,在确保上市公司对标的公司的控制权及上市公司整体战略得以实施的前提下,上市公司将最大程度地保障瑞通芯源及其子公司的自主经营权,但是上市公司仍需在战略规划、财务控制、企业文化等方面进行全局安排与调整。

由于上市公司与标的公司在经营模式、公司治理、企业文化、商业习惯、监管环境、法律法规等方面存在差异,业务整合效果及发挥整合效益时间均存在一定的不确定性,从而导致整合出现困难的风险,影响上市公司预期目标的实现。

(二) 人员流失风险及核心技术泄密的风险

目标公司赛莱克斯提供 MEMS 芯片工艺开发及代工生产服务，其所处行业属于技术密集型行业。通过多年的发展，赛莱克斯已培养了一批具有丰富的产品工艺开发经验，对客户行业有着深刻理解，对客户需要能够准确把握的高素质人才队伍，为其良好的研发、生产和销售能力提供了有力支撑。因此，保持赛莱克斯人才队伍的稳定性，是其可持续发展的重要保障，也是上市公司与赛莱克斯在本次交易后发挥协同效应的关键一环。若在本次交易完成后，赛莱克斯发生较大的人才流失，则将对其未来经营产生不利影响，使双方无法实现预期的协同目标。

核心技术保密方面，通过多年的技术与工艺创新，赛莱克斯已经积累了领先的核心技术和丰富的生产制造经验。赛莱克斯的技术成果，除部分已申请专利外，尚有一部分技术成果以技术秘密、非专利技术的形式持有。虽然赛莱克斯制订了严格的保密制度，与其核心技术人员以及因业务关系可能知悉技术秘密的相关人员签订了保密协议，但并不能完全排除核心技术泄密的风险。核心技术是赛莱克斯保持快速发展和高盈利水平的关键，核心技术一旦失密，将会对赛莱克斯的利益产生不利影响。

（三）技术创新的风险

MEMS 制造行业属于技术及智力密集型行业，涉及电子、机械、光学、医学等多个专业领域，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素。若赛莱克斯不能正确判断未来产品及市场的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

（四）政府补助金额较大的风险

目标公司赛莱克斯的政府补助金额较高，报告期内计入当期损益的政府补助分别为 999.35 万元、274.35 万元及 499.83 万元。另外，根据交易对方北京集成电路投资中心、徐兴慧对赛莱克斯业绩作出的承诺，政府补助收入将包含在承诺利润中。赛莱克斯作为集成电路行业的高科技公司，承担着欧洲及瑞典政府相关的针对 MEMS 新工艺、新材料的研发项目，并收到与研发相关的欧盟政府补助。赛莱克斯未来是否能够获得补助与具体研发项目的申请紧密相关，未来公司能否持续获得政府补助存在不确定性。

（五）汇兑风险

本次收购的目标公司赛莱克斯的业务遍布北美、欧洲及亚洲等多个区域，日

常运营中涉及瑞典克朗、美元、欧元等多种交易币种，而上市公司合并报表的记账本位币为人民币，未来随着人民币、瑞典克朗、美元、欧元等币种之间汇率的不断变化，可能给公司未来运营带来汇兑风险。

(六) 本次交易形成的商誉减值风险

本次交易作价较标的公司账面净资产增值较多，根据企业会计准则，耐威科技本次收购瑞通芯源 100%的股权属于非同一控制下的企业合并，合并对价超出可辨识资产公允价值部分将形成高额的商誉。

根据备考合并财务报表，本次交易完成后，在耐威科技合并资产负债表中将增加 54,726.36 万元的商誉。本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值会直接影响上市公司的经营业绩，减少上市公司的当期利润，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响。

三、其他风险

(一) 股票价格波动风险

股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还要受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。由于以上各种不确定因素，公司股票价格可能产生脱离其本身价值的波动，给投资者造成投资风险。因此，提请投资者注意股市风险。

(二) 不可抗力风险

自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对本次交易的标的资产、本公司的财产、人员造成损害，并有可能影响本次交易的进程及本公司的正常生产经营。此类不可抗力发生可能会给本公司增加额外成本，从而影响本公司的盈利水平。

第三节 本次交易概述

一、本次交易的背景和目的

(一) 本次交易的背景

1、集成电路产业发展已上升至国家战略

集成电路产业是国家战略性、基础性产业，其发展水平代表着一个国家的综合实力和保障国家安全的能力。随着信息产业的深入发展、信息消费的持续升级，云计算、物联网、大数据、工业互联网等新兴产业的快速发展，各国都将集成电路产业作为抢占战略制高点的重要领域。根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32 号）的部署和要求，为加快培育和发展新一代信息技术等战略性新兴产业，2012 年 7 月 9 日，国务院制定了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。该规划描绘了电子核心基础产业发展路线图，提出推进微机电系统（MEMS）产业化，细化和落实支持集成电路的优惠政策，同时研究提出集成电路设计和芯片制造联动发展的优惠政策。2014 年 6 月，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出加速发展集成电路制造业，抓住技术变革的有利时机，突破投融资瓶颈，持续推动先进生产线建设。该纲要提出要大力发展微机电系统（MEMS）等特色专用工艺生产线，增强芯片制造综合能力，以工艺能力提升带动设计水平提升，以生产线建设带动关键设备和材料配套发展。2014 年，财政部和工信部共同推动设立了国家集成电路基金，目前其注册资本为 9,872,000 万元。在国家集成电路基金的带领下，北京、上海、湖北等产业聚集区也纷纷设立了地方政府投资基金，重点支持集成电路制造业，同时兼顾设计、封装测试、装备、材料等上下游环节。

2、国内外市场对 MEMS 产品需求巨大

随着微机械技术的发展，MEMS 产品在汽车电子、消费电子、工业设备、导航定位、生物医药等领域的应用日渐普及，MEMS 市场在不断创新中呈现出快速增长的趋势。2008 年以前，汽车电子是 MEMS 主要应用市场；2008 年以后，智能手机等终端产品日益涌现并占领 MEMS 主流市场，目前年产量超过 10 亿台；在未来，随着智能化的进一步发展，各种新兴应用领域如可穿戴设备、智能家居及工业 4.0 等将为 MEMS 提供更广阔的发展空间。据全球最权威的半导体咨询机构

Yole Development 预测,到 2018 年,MEMS 行业的产值将突破 220 亿美元。同时,据 Cisco 预计,到 2020 年,MEMS 终端应用产品会越来越丰富和多元化,届时将有 500 亿部设备连接到互联网,其应用领域将会逐步延伸并涵盖包括智能家庭、可穿戴设备、健康监测、独立老年生活、智能农业生产、资产跟踪、智能工厂与生产监控、智能社区等多个领域。作为物联网不可或缺的组成部分,MEMS 产品的使用量将呈指数级增长,预计 2018 年以后仍将保持超过 10%的年均复合增长率。

从国内市场来看,我国拥有全球规模最大的集成电路市场。苹果、三星、小米、华为、中兴等手机品牌在中国设厂生产加之汽车电子、物联网、无人机、智能家庭等概念产品的逐步兴起,以及可穿戴设备的蓬勃发展,国内市场对硅麦克风、加速度计、陀螺仪、电子罗盘、射频仪器、高精度压力传感器、气体传感器等 MEMS 器件的需求快速增长。中国地区已经成为过去五年全球 MEMS 市场发展最快的地区。2015 年,我国 MEMS 市场规模接近 300 亿元,且连续两年增幅高达 15%以上;到 2020 年,我国传感器市场增幅将进一步提升,年平均增长率将达到 20%以上,继续保持全球前列。

3、国内 MEMS 开发和生产能力严重匮乏

目前,MEMS 技术已经成为炙手可热的半导体技术之一,但现阶段国际主流的 MEMS 制造厂商均分布在欧美发达国家,并已经形成成熟体系。国外主流 MEMS 制造商不仅在生产设备和生产规模上具有较强优势,而且在 MEMS 工艺开发能力和开发速度上也远超国内,比如在硅麦克风、压力传感器和惯性传感器方面,国外主流 MEMS 厂商均已形成较为成熟的工艺,并且配备了专业的研发团队针对客户多样化的需求进行特定的工艺开发,从工艺开发到批量生产,国外 MEMS 厂商一般能在半年时间内形成具有较高良率的稳定产量。

中国已经成为世界上最大的手机和汽车市场,然而,中高端传感器和传感器芯片却严重依赖进口,中国 MEMS 产业的落后与国内市场的旺盛需求形成巨大反差。国内 MEMS 研究集中于科研院所,但产业化仍处于萌芽状态。近几年,在政府的大力支持和各渠道资金的持续投入下,本土 MEMS 产业快速成长。目前,国内已在上海、无锡、苏州等地建成多条 MEMS 产线,但生产能力较弱,尚未形成规模化产能。

近年来,国内建立了一些 MEMS 工艺服务平台,为 MEMS 初创公司提供了技术

研究和开发平台，对国内 MEMS 工艺开发和产品生产起到了促进作用，但目前多数市场参与者仍然处于从试验生产阶段到产业化阶段的转型过程中，产能无法满足国内外市场对 MEMS 产品的巨大需求。通过引进国外先进的体硅制造技术、微机械工艺流程开发技术及规模量产经验，建设 8 吋线或更高级 MEMS 生产线，提升国内 MEMS 开发和生产能力的需求显得尤为迫切和重要。

（二）本次交易的目的

1、打通惯性导航垂直产业链，提升产品精度与集成度

MEMS 芯片是陀螺仪、加速度计等惯性传感器的“心脏”。通过本次交易，公司将获得国际先进的 MEMS 工艺开发和生产平台，实现自主开发及生产高性能 MEMS 陀螺仪、高精度 MEMS 加速度计等主要惯性器件的能力，打通惯性导航产业链中核心环节，围绕公司在导航定位领域制定的“器件-产品-系统-服务”一体化发展目标，形成惯性导航业务的全产业链布局，从而进一步奠定公司在国内惯性导航产业中的领先地位

公司已投入研发的 MEMS 相关项目包括“基于磁传感器辅助微机电（MEMS）惯导的姿态测量系统研制技术”、“高性能 MEMS 陀螺工程化关键技术与系统集成技术”、“基于 MEMS 惯性技术的步行者导航系统研制技术”、“微机械（MEMS）轻小型定位定向（POS）系统研制技术”和“小型化高精度航姿测量系统研制技术”，公司已掌握了部分技术并投入应用，结合以上技术基础，本次交易将大幅提升公司自主开发和生产高性能 MEMS 惯性传感器的能力，提高公司导航产品的精度与集成度，进一步缩小产品尺寸并降低生产成本，拓宽惯性导航产品的应用领域。

2、掌握国际领先的 MEMS 制造技术，落实国家战略和产业发展需求

本次交易的目标公司赛莱克斯是全球领先的 MEMS 芯片制造商，长期专注于 MEMS 工艺开发及代工业务，具备优越的技术水平和工艺开发能力。赛莱克斯的优越性主要体现在以下三点：其一，赛莱克斯产品实现能力强，能够生产加速度传感器、惯性传感器、流量传感器、红外传感器等多种 MEMS 传感器，光学器件、生物器件、硅麦克风等多种 MEMS 器件，以及各种 MEMS 基本结构模块。其二，赛莱克斯技术实力雄厚，拥有目前业界最领先的硅通孔绝缘层工艺和制造平台，研发出包括深反应离子刻蚀等在内的 57 余项 MEMS 核心专利，以上专利为实现功能化晶圆级封装和 3D 集成提供了关键工艺。同时，赛莱克斯还具备开发和应用特殊材料的能力，如压电材料、磁性材料和聚合物材料等，在向多名客户提供工艺

开发的持续实践中积累了大量的经验诀窍以及多项目并行开发能力。其三，赛莱克斯拥有较为高效的 MEMS 定制工艺开发能力，采用结构化的工艺集成模块，在标准化和灵活性中取得高效平衡，可在保证产品较高良率的同时提供 MEMS 定制工艺开发服务，协助客户实现 MEMS 产品量产。

本次交易完成后，上市公司将获得赛莱克斯 98% 的控制权。赛莱克斯代表着目前世界 MEMS 芯片制造领域的一流水平，这将对培养上市公司的 MEMS 生产能力、推动我国 MEMS 产业化进程起到至关重要的作用。交易完成后，上市公司拟以标的公司瑞通芯源为平台，在国内新建 8 吋 MEMS 生产线，依托赛莱克斯成熟的制造技术和生产管理模式，释放产能，形成规模经济，降低生产成本，满足公司乃至国内外 MEMS 产品的巨大需求。利用赛莱克斯的工艺开发及生产能力，公司将构建国内最先进的 MEMS 产业化平台，孵化上下游产业，促进产业集聚，实现京津冀地区 MEMS 全产业链集群发展，推动我国 MEMS 产业快速发展。

3、提升上市公司的整体规模和盈利能力

本次交易完成后，耐威科技将形成惯性导航、卫星导航及 MEMS 芯片生产齐头并进的业务格局。交易对方北京集成电路投资中心、徐兴慧承诺目标公司赛莱克斯 2015 年、2016 年、2017 年的承诺净利润分别为 3,333.90 万瑞典克朗、3,799.80 万瑞典克朗、5,664.50 万瑞典克朗，三年累计承诺净利润合计数不低于 12,798.2 万瑞典克朗。本次交易完成后，瑞通芯源将纳入上市公司的合并范围，上市公司的营业收入、净利润水平将得到显著提升，有助于提升上市公司的整体规模和盈利能力，为股东带来更好的投资回报。

二、本次交易的具体方案

（一）本次交易方案概述

本次交易包括发行股份购买资产和配套融资两部分。

1、购买瑞通芯源 100% 股权

本次交易中，耐威科技拟以发行股份的方式购买北京集成电路投资中心、徐兴慧合计持有的瑞通芯源 100% 的股权。

2、发行股份募集配套资金

耐威科技拟向亦庄国投、周志文和杨云春非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 74,972.04 万元，不超过本次交易总额（本次收购瑞通芯源

100%股权对价为 74,987.5028 万元)的 100%，扣除本次交易相关费用后拟用于标的公司建设北京 8 吋 MEMS 生产线。

耐威科技本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的履行及实施。

本次交易完成之后，耐威科技将直接持有瑞通芯源 100%的股权。本次交易完成之后，耐威科技的实际控制人仍为杨云春先生，不会导致公司控制权变更。

(二) 交易对方和发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为北京集成电路投资中心、徐兴慧；本次配套融资的发行对象为亦庄国投、周志文和杨云春。

(三) 交易标的

本次发行股份购买资产部分的交易标的为瑞通芯源 100%的股权。

(四) 标的资产交易价格及溢价情况

本次交易标的资产的价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告为基础确定。天健兴业采用资产基础法对标的资产进行评估，评估基准日为 2015 年 8 月 31 日。根据天健兴业出具的天兴评报字(2015)第 1269 号《评估报告》，截至 2015 年 8 月 31 日，标的资产瑞通芯源净资产账面价值为 48,984.36 万元，评估价值为 75,315.87 万元，增值额为 26,331.51 万元，增值率为 53.75%。

以上述评估值为参考依据，经上市公司与交易对方协商，最终标的资产交易价格为 74,987.5028 万元。

(五) 本次发行股份情况

1、发行股份价格

(1) 购买资产发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为耐威科技第二届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，计算方式为：

前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易的总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易的总量。

据此计算, 公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 97.08 元/股, 本次发行股份价格为 87.38 元/股。最终发行价格尚需经公司股东大会审议通过并获中国证监会的核准。

(2) 配套融资发行价格

本次发行股份募集配套资金的发行价格为耐威科技第二届董事会第十四次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 87.38 元/股。最终发行价格尚需经公司股东大会审议通过并获中国证监会的核准。

2、发行股份数量

(1) 购买资产发行数量

本次交易支付的股份对价为 74,987.5028 万元, 按照发行价格 87.38 元/股计算, 对应的非公开发行业股票的数量合计为 858.177 万股, 最终的发行数量将以拟购买资产成交价为依据, 由公司董事会提请股东大会审议批准, 并经中国证监会核准后确定。

(2) 配套融资发行数量

本次交易拟募集配套资金总额预计不超过 74,972.04 万元。按照发行价格 87.38 元/股计算, 向亦庄国投、周志文和杨云春非公开发行业股份数量不超过 858 万股。

(3) 合计发行股份数量

本次交易中, 上市公司预计将合计发行 1,716.177 万股股份, 占交易完成后公司总股本的 16.9647%, 具体情况如下:

单位: 万股

发行对象/认购人	发行数量	占交易完成后总股本比例
北京集成电路投资中心	857.3188	8.4747%
徐兴慧	0.8582	0.0085%
亦庄国投	686.0000	6.7812%
周志文	114.0000	1.1269%
杨云春	58.0000	0.5733%
合计	1,716.1770	16.9647%

在本次发行股份购买资产之定价基准日至发行日期间, 上市公司如有发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权行为, 发行数量亦作相应调整。

3、股份锁定安排

(1) 购买资产发行股份的锁定期

根据《重组办法》的规定,北京集成电路投资中心、徐兴慧通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。

上述新增股份发行完毕至上述锁定期届满之日止,北京集成电路投资中心、徐兴慧由于耐威科技送红股、资本公积转增股本等原因增持的耐威科技股份,亦应遵守上述承诺。

(2) 募集配套资金发行股份的锁定期

根据《重组管理办法》的规定,亦庄国投、周志文和杨云春通过本次配套融资所取得的上市公司非公开发行的股份,自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。

上述认购的股份发行完毕至上述锁定期届满之日止,亦庄国投、周志文和杨云春由于耐威科技送红股、资本公积转增股本等原因增持的耐威科技股份,亦应遵守上述承诺。

(六) 业绩承诺和业绩补偿

1、业绩承诺

北京集成电路投资中心及徐兴慧承诺,赛莱克斯 2015 年、2016 年、2017 年的承诺净利润分别为 3,333.90 万瑞典克朗、3,799.80 万瑞典克朗、5,664.50 万瑞典克朗,三年累计承诺净利润合计数不低于 12,798.2 万瑞典克朗。

承诺净利润指赛莱克斯 2015 年、2016 年、2017 年实现的经调整后的扣除非经营性损益后的净利润,包括计入当期损益的欧洲及瑞典的政府补助,但不包括计入当期损益的股权交易相关费用。具体计算公式为:经调整后的扣除非经营性损益后的净利润=扣除非经常性损益后的净利润+计入当期损益的欧洲及瑞典的政府补助+计入当期损益的股权交易相关费用的绝对值。

2、业绩承诺差额的确定

承诺年度期满后,上市公司应当具有证券期货从业资格的会计师事务所在承诺年度结束后的 3 个月内对赛莱克斯在承诺年度内累计实现的承诺净利润情况出具专项审核意见。

3、补偿义务

承诺年度期满后,如果赛莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润高于或等于承诺净利润合计数的 95%,则北京集成电路投资中心、徐兴慧无需进行补偿;

如果赛莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润低于承诺净利润数的 95%，则北京集成电路投资中心、徐兴慧需向上市公司支付股票补偿，支付股票补偿的公式为：

北京集成电路投资中心、徐兴慧合计需补偿的股票数量=（1－赛莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润÷承诺净利润合计数）×本次交易上市公司向北京集成电路投资中心、徐兴慧发行的股票总数

北京集成电路投资中心、徐兴慧需补偿的股票数量不超过其在本次交易中获得的全部股票总数的 30%。

如上市公司在承诺年度内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数相应调整为：补偿股份数（调整后）=应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。

如上市公司在承诺年度内实施现金分配的，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×应补偿股份数。

北京集成电路投资中心、徐兴慧之间按照其在本次交易前持有的瑞通芯源的股权比例计算各自应当补偿股份数。

如发生上述应回购股份的情形，上市公司应当在上市公司和北京集成电路投资中心均同意的具有证券期货从业资格的会计师事务所对赛莱克斯在承诺年度内累计实现的承诺净利润情况出具专项审核意见之日起 10 个交易日内，计算应回购的股份数量并以书面方式通知北京集成电路投资中心、徐兴慧累计实现的承诺净利润数小于承诺净利润合计数的情況以及应补偿股份数量。

北京集成电路投资中心、徐兴慧应在收到上述书面通知之日起 10 个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将其需补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户。同时，上市公司应当发出召开上市公司董事会和股东大会的通知，经股东大会审议通过，将由上市公司按照人民币 1 元的总价回购该等补偿的股份并按照有关法律规定予以注销，并以书面方式通知北京集成电路投资中心、徐兴慧。如果上市公司股东大会未通过，上市公司应在股东大会决议公告后 10 个工作日内书面通知北京集成电路投资中心、徐兴慧，北京集成电路投资中心、徐兴慧应在收到上述书面通知后 2 个月内将应补偿股份无偿划转给上市公司赠送股份实施公告中确认的股权登记日在册的上市公司股东，股东按其持有的股份数量占总股本的比例获赠股份。

三、本次交易的决策过程和批准情况

(一) 本次交易已履行的决策过程

1、上市公司的决策过程

2015年8月3日,因拟披露重大事项,公司股票于开市时起实施临时停牌;
2015年8月4日,因筹划重大资产重组事项,公司股票于开市时起继续停牌。

2015年11月2日,经第二届董事会第十一次会议审议通过并经深交所同意,公司股票继续停牌。

2015年12月30日,公司与北京集成电路投资中心、徐兴慧签署《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》。

2015年12月30日,公司与亦庄国投、周志文和杨云春签署《股份认购协议》。

2015年12月30日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过本次交易相关议案。

2、交易对方的决策过程

2015年8月26日,北京集成电路投资中心投资决策委员会审议通过了《关于Epton项目本基金向上市公司出售亦庄公司股权的决议》,同意拟向耐威科技出售北京集成电路投资中心所持有的瑞通芯源99.9%的股权。

3、标的公司的决策过程

2015年12月25日,瑞通芯源召开股东会,审议通过北京集成电路投资中心及徐兴慧将其持有的瑞通芯源股权转让给耐威科技的事项;徐兴慧同意放弃对北京集成电路投资中心所拥有的瑞通芯源股权的优先购买权,北京集成电路投资中心同意放弃对徐兴慧所拥有的瑞通芯源股权的优先购买权。

(二) 本次交易尚需履行的审批程序

本次交易已由上市公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚需履行以下批准程序:

(1) 上市公司股东大会审议通过本次交易;

(2) 亦庄国投的国资主管部门审批通过亦庄国投参与认购上市公司非公开发行股票事宜;

(3) 中国证监会核准本次交易。

本次交易能否获得上述通过或核准及获得上述通过或核准的时间存在不确定性。公司提请广大投资者注意投资风险。

四、本次交易构成重大资产重组

截至 2014 年 12 月 31 日,上市公司经审计的合并资产总额为 39,436.25 万元,合并归属于母公司所有者权益为 26,370.12 万元。本次交易拟购买的标的资产交易价格为 74,987.5028 万元,占上市公司近一个会计年度合并资产总额的比例为 190.15%,超过 50%;占上市公司最近一个会计年度合并归属于母公司所有者权益的比例为 284.37%,且交易金额超过 5,000 万元。综上所述,本次交易满足《重组管理办法》第十二条对于构成重大资产重组标准的要求。因此,本次交易构成重大资产重组。

五、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方为北京集成电路投资中心、徐兴慧,募集配套资金的认购对象为亦庄国投、周志文和杨云春。

本次交易前,交易对方北京集成电路投资中心、徐兴慧与上市公司之间不存在关联关系及关联交易。本次交易完成后,北京集成电路投资中心持有上市公司 8.47%的股份,根据《上市规则》,北京集成电路投资中心为上市公司潜在关联方。本次募集配套资金的认购对象之一亦庄国投拟认购上市公司 6.78%的股份,根据《上市规则》,亦庄国投为上市公司潜在关联方。上市公司与以上潜在关联方之间的交易构成关联交易。

本次交易前,募集配套资金的认购对象之一杨云春持有公司 55.73%的股份,为上市公司控股股东、实际控制人。因此,本次募集配套资金系本公司与控股股东之间的交易,构成关联交易,上市公司在召集董事会、股东大会审议相关议案时,关联董事、关联股东杨云春将回避表决。

六、本次交易不构成借壳上市

本次交易前,公司总股本为 8,400 万股,杨云春先生持有公司 4,681.0907 万股股份,持有上市公司 55.73%的股份,为公司的控股股东及实际控制人。本次交易中,公司预计将发行 1,716.177 万股股份,发行完成后,公司总股份将增

至 10,116.177 万股，杨云春先生持有公司股份比例将降至 46.85%，公司控股股东及实际控制人仍为杨云春先生。

本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不构成借壳上市。

七、本次交易对上市公司的影响

(一) 本次交易对公司股权结构及控制权的影响

本次交易前，公司总股本为 8,400 万股。本次交易及配套融资，公司预计将发行 1,716.177 万股股份，发行完成后，公司总股份将增至 10,116.177 万股。本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

单位：万股

序号	股东名称	本次交易之前		本次交易之后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	杨云春	4,681.0907	55.73%	4,739.0907	46.85%
2	北京集成电路投资中心	-	-	857.3188	8.47%
3	徐兴慧	-	-	0.8582	0.01%
4	亦庄国投	-	-	686.0000	6.78%
5	周志文	-	-	114.0000	1.13%
6	其他股东	3,718.9093	44.27%	3,718.9093	36.76%
合计		8,400.00	100.00%	10,116.1770	100.00%

注：本次交易前后的股东持股情况系根据截至 2015 年 8 月 3 日（因拟披露重大事项停牌日）公司登记在册的股东持股数据，结合本次交易预计增加股份数量计算。

本次交易前，杨云春先生持有公司 4,681.0907 万股股份，占公司总股份的 55.73%，为公司的控股股东及实际控制人。本次交易完成后，杨云春先生持有公司股份的比例将降至 46.85%，公司控股股东及实际控制人仍为杨云春先生。本次交易未导致公司控制权发生变化。

本次交易完成后，耐威科技的股本总额为 10,116.1770 万股，社会公众股占本次发行后上市公司股本总额的比例不低于 25%，满足股票上市条件。

(二) 本次交易对上市公司主要财务数据和财务指标的影响

公司按照本次交易完成后的架构编制了最近一年一期的备考合并财务报表，并已经天圆全会计师事务所审阅。根据上市公司 2014 年经审计财务报告、2015 年 1-8 月经审阅的的财务报告以及天圆全阅字[2015]000004 号备考财务报告，本次交易前后，公司最近一年一期主要财务数据、财务指标及变动情况如下：

期间	项目	实现数	备考数	变动率
2014 年 度 /2014 年末	资产总额（万元）	39,436.25	125,936.03	219.34%
	负债总额（万元）	12,494.57	24,809.48	98.56%
	归属于母公司所有者权益（万元）	26,370.12	100,165.82	279.85%
	每股净资产（元/股）	4.19	13.99	233.89%
	资产负债率	31.68%	19.70%	-37.82%
	营业收入（万元）	16,939.10	37,407.49	120.84%
	营业利润（万元）	4,974.84	4,631.28	-6.91%
	利润总额（万元）	6,139.49	7,917.45	28.96%
	净利润（万元）	5,485.91	6,521.06	18.87%
	归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,394.33	6,408.77	18.81%
	基本每股收益（元/股）	0.86	0.90	4.65%
2015 年 1-8 月/2015 年 8 月末	资产总额（万元）	62,028.92	144,926.15	133.64%
	负债总额（万元）	6,819.11	14,315.84	109.94%
	归属于母公司所有者权益（万元）	54,640.97	129,628.47	137.24%
	每股净资产（元/股）	7.71	16.31	111.54%
	资产负债率	10.99%	9.88%	-10.10%
	营业收入（万元）	7,415.23	21,518.21	190.19%
	营业利润（万元）	765.89	1,151.66	50.37%
	利润总额（万元）	1,909.10	2,796.78	46.50%
	净利润（万元）	1,697.62	2,751.24	62.06%
	归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,653.84	2,685.87	62.40%
	基本每股收益（元/股）	0.23	0.34	47.83%

本次交易完成后上市公司总资产规模、净资产规模、营业收入规模、净利润水平均有明显增加，基本每股收益有所增加。本次交易完成后上市公司不存在因并购重组交易而导致当期每股收益被摊薄的情况。

(本页无正文,为《北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》之签章页)

北京耐威科技股份有限公司

年 月 日